

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240410

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：年度投资者交流电话会议
参与单位名称及人员姓名	招商基金：张香滢、王忠波、袁哲航；长信基金：胡梦承；圆信永丰基金：邹维、胡春霞、马红丽；兴全基金：吴钊华；天弘基金：张磊；太平洋保险：张玮；睿郡资产：董承非、张航、刘力；理成资产：卢超、吴圣涛；睿远基金：周睿洋、朱璘；南方基金：郑勇、吴春林、陈卓；嘉实基金：王子瑞、洪流；汇添富基金：徐志华、马翔；高毅资产：赵浩、张新和；东方阿尔法基金：唐雷、梁少文；博时基金：李宜泽；SCHRODERS INVESTMENT：ZhengMaggie、LeeJack 等 482 名投资者及证券人员
时间	2024 年 4 月 10 日上午 10:00~11:00
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长朱双全先生、董事会秘书杨平彩女士、财务总监姚红女士、投资者关系经理朱梦茜女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司 2023 年度经营情况，半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：公司 2023 年的发展思路和成绩有哪些？</p> <p>答：2023 年度，公司紧抓半导体材料行业的战略窗口期，结合经营发展需要持续进行业务扩张和产业布局，进一步夯实了公司作为材料平台型企业的综合竞争力，主要的资源投入有三个方面：第一是研发投入增加，2023 年公司研发投入 3.82 亿元，同比增长 19.84%，占营业收入的比例为 14.33%，以支持抛光液、封装材料、晶圆光刻胶等新业务的开发需求；第二是公司本部材料平台的持续打造和完善，重点围绕新业务增加了人员配置；第三是潜江 CMP 软垫工厂的逐步拉通和仙桃园区的快速建成，体现了公司对相关产品快速放量的信心，也增强了公司的市场竞争力。上述资源投入虽然一定程度上影响了 2023 年的经营业绩，但为公司在未来两年进入半导体材料业务收入、利润增长快车道打下了坚实的基础。</p> <p>问 2：公司 CMP 抛光垫业务有哪些突破，竞争力有哪些？</p>

答：公司 CMP 抛光垫产品收入在 2023 年逐季度上升，展现出正常恢复态势，特别是在第四季度实现 1.49 亿的销售收入，创历史单季度收入新高；2024 年 CMP 抛光垫业务也会持续进行市场开拓，努力保持良好的同比增长趋势。除了业绩体现外，公司在 CMP 抛光垫领域的综合竞争力多年来也在不断强化，主要包括：第一是原材料自主化进一步提升，如核心原材料缓冲垫、微球都在 2023 年取得不错进展，这加强了对产品品质的控制力和盈利空间；第二是产品布局的持续跟进，如已有型号产品的迭代和新产品配合客户快速响应持续开发，这是公司技术能力和应用理解的体现；第三是生产工艺的不断进步，如良率的提升、生产环节优化等，这提高了生产效率，降低成本。公司在 CMP 抛光垫领域取得如今的成绩是十几年积淀的结果，没有时间积累很难拥有公司在抛光垫产品上的强竞争力，公司相信未来 3~5 年内在这个产品上可以维持国产替代领先优势。

问 3：公司柔性显示材料取得了哪些进展，预期如何？

答：2023 年，公司显示材料产品销售收入 1.74 亿元，同比增长 267.82%；其中第四季度实现销售收入 6,673 万元，环比增长 17.46%，同比增长 174.86%，稳定放量趋势明显。增长的来源主要有两个：一是公司在客户端的渗透程度不断加深，即市场占有率的提升；二是显示行业从 23 年下半年开始处于强力复苏的阶段，相应的下游面板客户的稼动率提升，带来了材料用量的上升。2024 年，公司将继续推进半导体显示材料业务的产品开发和市场开拓，一方面推动更多显示材料新品导入客户，另一方面争取成为更多家面板客户相应材料产品的第一供应商，同时公司也会持续关注在中尺寸柔性显示领域的市场机会，努力保持半导体显示材料业务的收入高速增长态势。

问 4：公司 CMP 抛光液业务的推进情况如何？

答：公司 CMP 抛光液、清洗液业务是新材料业务端第三块正在放量增长的业务，2023 年度实现产品销售收入 0.77 亿元，同比增长 330.84%；其中第四季度实现销售收入 2,890 万元，环比增长 32.96%，同比增长 294.61%。去年主要做了两个方面的工作，一是抛光液全型号布局的持续推进，公司在客户端在售产品的型号数量增长明显，同时也有更多型号处于验证导入阶段；二是仙桃园区万吨级 CMP 抛光液及配套研磨粒子扩产项目的完工试产，为公司未来多型号抛光液产品快速上量提供了足够的产能空间，也增强了客户导入公司抛光液产品的信心。2024 年度，随着新产品的导入和产品线的增加，业务收入规模有望持续快速增长，公司争取实现该业务的大幅减亏或盈利。

问 5：公司高端晶圆光刻胶的进展怎样？

答：在高端晶圆光刻胶领域，公司同步开展了产品开发、市场推广、原材料自主化、产线建设等工作。目前公司已布局 16 支国内还未突破的主流 KrF/ArF 光刻胶，已完成 7 支产品的客户送样，均获得客户认可，其余产品均计划在 2024 年完成客户送样。此外，设备品类齐全的材料分析和应用评价平台已经建成，潜江一期小规模光刻胶量产线的建设基本完成，潜江二期 300 吨光刻胶量产线的建设也于 2023 年下半年启动。整体来看，虽然公司

	<p>在该领域布局的时间较短，但这不到两年内取得突破和进展是非常迅速的，这是公司综合技术实力的体现，也是客户端积极支持的结果。</p> <p>问 6：公司先进封装材料业务的节奏规划如何？</p> <p>答：公司先进封装材料业务孵化了几年时间，早期侧重于更先进工艺中运用的封装材料，如临时键合胶等，相关产品在国内成熟应用还需要时间。从 2023 年开始，公司把更多资源放在了国内用量较大，且存在国产替代空间的封装 PSPI 领域，目前已有多款产品在客户端验证，争取在 2024 年取得一些突破。</p> <p>问 7：公司 23 年半导体业务的毛利率较 22 年降低，原因是什么？</p> <p>答：公司半导体材料及芯片业务的整体毛利率同比下降 6.21 个百分点，主要是整体产品销售结构变化较大(2022 年主要产品为 CMP 抛光垫，而 2023 年 CMP 抛光液、清洗液和柔性显示材料 YPI、PSPI 新材料产品迅速起量)，影响整体毛利率水平所致。从每种新材料单品来看，2023 年公司相关产品的盈利能力得到了较好的保持，随着 2024 年销售量的上升，相应半导体材料的高毛利水平能得到进一步体现。</p> <p>问 8：公司打印复印通用耗材的情况如何？</p> <p>答：2023 年度公司打印复印通用耗材板块（不含打印耗材芯片）实现产品销售收入 17.86 亿元，同比下降 8.08%（如剔除珠海天硌出表因素影响则同比下降 4%），下降的原因主要是公司的经营策略有所调整，从 23 年开始强调盈利导向，同时在打印耗材这个竞争相对成熟的行业里重点围绕降本增效巩固核心竞争力，如在珠海硒鼓成品端通过人力资源整合、组织结构优化，进一步提升人效目标；推进费用管控各项举措，进行采购降本、仓储物流降本及其他运营降本工作，提高了盈利能力。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 04 月 10 日